

免洗助焊笔

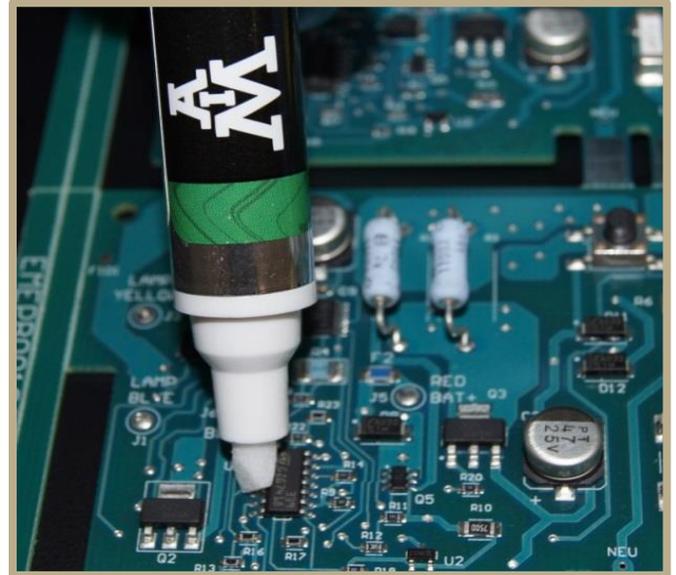
特性

- ▶ 无加热状态条件下，通过 IPC SIR-004A 和 -004B 测试
- ▶ 低残留
- ▶ 与所有 AIM 产品匹配
- ▶ 专门为返工设计
- ▶ 无卤

描述

AIM 免洗助焊笔是一款中低残留，免清洗液态助焊剂，用于实芯锡线焊接。此款 NC 助焊剂在化金，化锡，化银，裸铜，喷锡 和有机保焊基板上提供了优异的活性能力，低残留，无导电性，无需清洁。NC 助焊剂无加热条件下通过 IPC-004A and -004B SIR 测试，从而为电子线路板提供的可靠的安全性。

特点



处理以及储存

参数	时间	温度
密封保质期	1 年	室温

不可靠近火源存放。避免阳光直射以免降低产品质量。免洗助焊笔可直接使用，请重新密封未使用完产品。

应用

AIM 免洗助焊笔可用于精密的助焊剂应用操作。将加入的助焊剂液体送到笔尖。可只应用在需要焊接的区域，避免溢出。

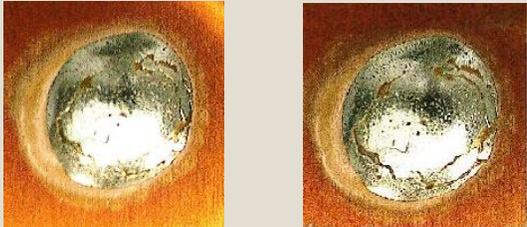
清洁

免洗助焊笔可用有皂化剂或其它清洁溶剂清洗。建议用去离子水做最后清洗。请联系 AIM 获取更多信息。

安全

请保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 MSDS 信息。请勿在未核准容器内处理任何有害物质。

测试数据小结

名称	测试方法	结果	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ROLO	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1	ROLO	
名称	测试方法	结果	图像
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	<p>之前 之后</p> 
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	0.0	无卤
定量卤化物、氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	通过	无氟
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过	可应要求提供结果
	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过	可应要求提供结果
电化迁移	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	通过	

名称	测试方法	结果	图像
助焊剂固体含量、 非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.57% 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	12.82 mg KOH 每克助焊 剂 典型值	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.79 (水 = 1) 典型值	
pH 值(1% 溶液 /水)	ASTM D5464 ASTM G51	酸性	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	淡黄色	